

# YS88

## 多功能异型模块贴片机



- ✓ 可对应0402 芯片~□55mm元件、长接头的广范围异形元件
- ✓ 对象元件的高度可对应25.5mm
- ✓ 可进行10~30N的简易贴装载重控制
- ✓ 全部时间，QFP贴装绝对精度 $\pm 30 \mu\text{m}$ 、QFP贴装反复精度 $\pm 20 \mu\text{m}$
- ✓ 可对应多功能异形要求、具有8,400CPH(相当于0.43秒/CHIP:最佳条件)的贴装能力
- ✓ 对应L尺寸基板(L510×W460mm)
- ✓ 对应主体内置式割带器选配件。
- ✓ 符合CE安全规格(EC机械指令及EMC指令)

### 基本规格

机型	YS88(型号:KJH-000)
对象基板	L50×W50mm ~L510×W460mm (注1)(注2)
贴装效率 (最佳条件)	8,400CPH/CHIP(相当于0.43秒/CHIP)
贴装精度 (本公司标准元件)	绝对精度( $\mu + 3\sigma$ ): $\pm 0.05\text{mm}$ /CHIP、 $\pm 0.03\text{mm}$ /QFP 重复精度( $3\sigma$ ): $\pm 0.03\text{mm}$ /CHIP、 $\pm 0.02\text{mm}$ /QFP
对象元件	0402(mm系名称)~□55mm元件、SOP/SOJ、QFP、接头、PLCC、CSP/BGA、长接头(W45×L100mm以下)(注3)(注4) 简易贴装载重控制(10~30N)，需要压入贴装异形元件(特殊接头等) 对象元件高度25.5mm以下(注5) 搬入前基板上方允许高度6.5mm以下
元件种类	90种(最大/换算成8mm卷带)(注1)
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz
供气源	0.45MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸 (注6)	L1,665×W 1,562(盖板端)×H 1,445mm(盖板上) L1,665×W 1,615(整批更换台车导轨端)×H1,445m(盖板上)
主体重量	约1,650kg(仅主体)